

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于部分生产线实施技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

（一）本次投资的基本情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善及优化产品多元化布局，精准把握高端铜箔市场发展机遇，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，拓展公司未来发展空间，拟实施安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品技术改造项目，对厂区部分工场现有生箔机开展系统性升级改造，配套新增表面处理生产线及相关附属设施，建成后可实现以高附加值 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 6,600.12 万元；拟对铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理生产线进行技术改造，将工场原有的部分锂电铜箔生产线转为生产电子电路铜箔，建成后可实现以高附加值的 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 8,815.95 万元。

（二）本次投资的审批情况

2026 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分生产线实施技术改造项目的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金 15,416.07 万元实施部分生产线技术改造项目。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规等规范性文件及公司制度文件的规定，本次投资金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体一：

1. 名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2. 公司类型：股份有限公司

3. 统一社会信用代码：91341700MA2N8LN173

4. 注册资本：82,901.5544 万元

5. 住所地：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号

6. 法定代表人：甘国庆

7. 经营范围：电子铜箔制造销售及服务，铜商品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 79.08 亿元，净资产 56.10 亿元，2026 年 1-6 月，实现营业收入 40.21 亿元，利润总额 2.58 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.15 亿元。（以上财务数据未经审计）

投资主体二：

1. 名称：铜陵铜冠电子铜箔有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 统一社会信用代码：91340700MA2NH25G2R

4. 注册资本：56,000 万万元

5. 住所地：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段 789 号

6. 法定代表人：印大维

7. 经营范围：电子铜箔制造、销售及服务，铜材、铜合金制造、销售及服务，铜商品销售，房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 29.67 亿元，净资产 6.82 亿元，2026 年 1-6 月，实现营业收入 13.81 亿元，利润总额 0.68 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.51 亿元。（以上财务数据未经审计）

三、项目基本情况

项目一：

1. 项目名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品升级技改项目

2. 建设目标：本项目建成后实现以高附加值 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能。

3. 建设内容：本项目拟将部分生箔工序进行系统性升级改造，并为之配套增

补 1 台表面处理生产线及配套设施。

4. 项目投资：本项目总投资为 6,600.12 万元。

5. 建设地点：安徽省池州市经济技术开发区安徽铜冠铜箔集团股份有限公司厂区。

6. 建设周期：预计 12 个月。

7. 本项目已获得池州经开区经济发展局签发的项目备案，项目还需取得主管部门环评等批复。

项目二：

1. 项目名称：铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理技术改造项目

2. 建设目标：本项目建成后可实现以高附加值的 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能。

3. 建设内容：本项目拟新增表面处理生产线及其配套设备，将部分锂电箔生产线转为生产电子电路铜箔。

4. 项目投资：本项目总投资为 8,815.95 万元。

5. 建设地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜陵铜冠电子铜箔有限公司厂区。

6. 建设周期：预计 12 个月。

7. 本项目已获得铜陵经开区经济发展局签发的项目备案，项目还需取得主管部门环评等批复。

四、投资项目的资金来源

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品升级技改项目及铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理技术改造项目的预计总投资为 15,416.07 万元，公司将使用自有资金及自筹资金。

五、投资项目目的和对公司的影响

随着 5G/6G 通信、高端服务器、高速数据中心、先进封装等下游应用的快速放量，高端电子铜箔市场需求快速增长，HVLP 铜箔供不应求。公司 HVLP 铜箔技术领先，但现有产线制约产能释放，为了满足高端 HVLP 铜箔市场迫切需求，加快国产替代进程，满足核心客户需求，进一步提升市场竞争力和盈利能力，因此，启动本次技术改造项目是公司把握战略窗口期、构筑长期竞争壁垒、实现高质量发展的必然选择。

六、投资项目的风险提示

本项目具有一定的建设周期，存在因环保、政策、市场波动及行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2026 年 10 月 28 日